

强于大市

半导体行业周报

三季度业绩普遍高增长，TSMC、ASML、Lam Research 对2022年及以后的行业前景普遍乐观

半导体材料国产化进程提速，国内半导体设备厂商持续推新，有力推动新工艺覆盖和国产化替代。晶圆代工产能及设备需求将持续以较高速增长，封测市场也将保持高景气，半导体全产业链持续受益。继续推荐半导体设备、材料等板块。

行业动态：

- **IPO 进度：**炬芯科技已注册；英集芯、思特威待上会；恒烁股份已受理；华微科技已申报。截至2021/10/24，共有131家半导体企业申报IPO、开展上市辅导等，炬芯科技、英集芯、思特威、恒烁股份、华微科技的上市进度上周有所变更。
- **三季度业绩普遍高增长。**截至10月24日，上周共有8家半导体公司发布2021年前三季度业绩公告，其中7家净利润同比增幅超100%。国科微前三季度归母净利润同比大幅增长11918.19%，实现净利润约1.81亿元，主要因为多个产品线收入增加较多所致。晶丰明源前三季度归母净利润较上年同期大幅增长1818.71%，实现净利润约5.73亿。
- **半导体材料：**荣耀半导体材料嘉善厂投产，众合科技表示半导体材料生产未受国家限电政策明显影响。10月19日，荣耀半导体材料宣布其位于浙江嘉善的新工厂正式试运营，嘉善工厂主要从事大尺寸和高端晶圆包装产品的研发和生产，提供安全的晶圆保护、精确的自动化接口等定制化产品和服务。众合科技于上证E互动平台表示半导体材料业务未受国家限电政策影响，公司经营延续上半年良好发展态势。
- **半导体设备：**盛美半导体的客户全球化再进一步，TSMC、ASML、Lam Research 普遍看好2022年及中长期半导体行业前景。10月22日，中微公司临港总部和研发基地项目开工仪式在临港新片区项目现场举行。盛美半导体也于22日宣布收到全球主要半导体制造商的Ultra C SAPS兆声波清洗设备DEMO订单，预计该订单将于22年一季度在客户位于中国地区的工厂安装调试，而10月20日宣布，盛美还收到一家亚洲的主要半导体制造商购买Ultra ECP map镀铜设备的DEMO设备订单，订单确定的交付日期在2022年初。尼康宣布开发下一代NSR-S636E ArF浸入式光刻机，预计将于2023年开始销售。华峰测控公布第三季报收入3.13亿元同比增长188%、净利润1.63亿元同比增长244%。
- **晶圆代工：**台湾晶圆厂拟再次提价，民德电子拟6000万增资晶圆代工公司。据环球时报报道，晶圆代工报价年底将继续上涨，其中台积电12月后或将调涨20%，联华电子也拟自明年1月起产品价格再次上调近10%。民德电子19日发布公告称，拟与晶圆代工企业浙江广芯微电子，及浙江广芯微电子的股东谢刚签订投资协议，增资6,000万元建设年产120万片6英寸高端特色硅晶圆代工生产线，达产后预计可实现产值10.2亿元。
- **封装测试：**深科达拟发行可转债募资不超3.6亿元布局封测设备/平板显示等项目。深科达22日发布公告，公司拟向不特定对象发行可转债募资不超过3.6亿元，用于惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目、平板显示器件自动化专业设备生产建设项目、补充流动资金等。

投资建议：

- **设备组合：**中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份；建议关注：晶盛机电、光力科技、神工股份
- **材料组合建议关注：**沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份
- **功率半导体组合：**新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技
- **模拟建议关注：**圣邦股份、思瑞浦、卓胜微（射频）
- **MCU：**兆易创新；建议关注中颖电子
- **其他：**韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

风险提示

- 疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；半导体材料国内市场增速放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

相关研究报告

《ASML 21Q3 业绩点评及电话会议纪要：在手订单196亿欧元交货持续到2023年，2022年存储客户采购需求乐观》20211021

《半导体行业周报：三季度业绩普遍高增长，台积电表示产能紧张延续至2022全年》20211018

《台积电21Q3 业绩点评及电话会议纪要：产能紧张延续至2022年，5G和HPC推动半导体行业结构性增长》20211017

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

半导体

证券分析师：杨绍辉

(8621)20328569

shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：余嫻嫻

(8621)20328550

yuanyuan.yu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

目录

拟 IPO 的半导体企业汇总	4
半导体设备国产化情况	8
2021 年前三季度业绩公告.....	9
行业数据回顾	10
上周信息汇总	14
风险提示.....	17

图表目录

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/24)	4
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/24)	5
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/24)	6
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/24)	7
图表 2. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化情况及主要国内厂家	8
图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总	9
图表 4. 全球半导体销售额当月值	10
图表 5. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比	10
图表 6. 日本半导体设备制造商出货额与同比	11
图表 7. 美国与国内半导体指数对比	11
图表 8. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比	11
图表 9. 美国与国内半导体指数对比(周度环比)	11
图表 10. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (周度环比)	11
图表 11. 申万半导体材料指数	12
图表 12. 全球半导体级硅片出货量	12
图表 13. 半导体器件封装材料进出口金额	13
图表 14. 半导体器件封装材料进出口单价	13
图表 15. 上周半导体相关个股周度涨跌幅	13

拟 IPO 的半导体企业汇总

截至 2021/10/24，共有 131 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等，炬芯科技、英集芯、思特威、恒烁股份、华微科技上周变更：

- **已注册**：炬芯科技（低功耗系统级芯片设计厂商）
- **待上会**：英集芯（数模混合芯片设计公司）、思特威（高性能 CMOS 图像传感器芯片）
- **已受理**：恒烁股份（存储芯片和 MCU 芯片设计企业）
- **已申报**：华微科技（MCU、FPGA、电源管理芯片设计企业）

炬芯科技为国内领先的低功耗系统级芯片设计厂商。主要从事中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，公司产品广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。

英集芯为数模混合芯片设计公司。主要从事电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售，主要产品包括电源管理芯片、快充协议芯片，产品可广泛应用于移动电源、快充电源适配器、TWS 耳机充电仓、车载充电器、无线充电器等。

思特威为高性能 CMOS 图像传感器芯片供应商。公司产品广泛应用于安防监控、机器视觉、智能车载电子等众多高科技应用领域，具有高信噪比、高感光度、高速全局快门捕捉、超宽动态范围、超高近红外感度、低功耗等特点。

恒烁股份为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和 ARM CortexM0+ 内核架构的 32 位 MCU 芯片，同时公司致力于开发基于 NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。

华微科技为芯片设计和电子应用产品供应商。公司主营产品包括可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、高速高精度 ADC/DAC、存储器、电源管理芯片、接口与驱动芯片以及高性能低功耗 MCU 等，广泛应用于通信、信号处理、控制等领域。

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截至 2021/10/24）

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	盛美股份	已注册	海通证券	2005	设备	清洗设备、FN、镀铜设备等
2	安路科技	已注册	中金公司	2011	设计	可编程逻辑器件（FPGA）、可编程系统级芯片（SoC）、及相关 EDA 软件工具和创新系统解决方案
3	灿勤科技	已注册	中信建投	2004	设计	微波介质陶瓷元器件
4	华海清科	提交注册	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
5	屹唐股份	提交注册	国泰君安、中金公司	2015	设备	刻蚀、去胶、退火
6	炬芯科技	已注册	申万宏源	2014	设计	蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等
7	东芯股份	提交注册	海通证券	2014	设计	24nm NAND、48nm NOR
8	【苏州】国芯科技	提交注册	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和应用
9	翱捷科技	提交注册	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
10	创耀科技	提交注册	海通证券	2006	设计	通信芯片
11	芯导科技	提交注册	国元证券	2009	设计	功率半导体
12	云天励飞	提交注册	中信证券	2014	设计	AI 芯片
13	必易微	提交注册	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
14	概伦电子	提交注册	招商证券	2010	软件	EDA 软件
15	华大九天	过会	中信证券	2009	软件	EDA 软件
16	晶导微	过会	中信证券	2013	分立器件	二极管、整流桥等分立器件、集成电路系统级封装(SIP)
17	长光华芯	过会	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
18	华卓精科	过会	东兴证券	2012	零部件	超精密测控装备部件及整机，首家光刻机双工件台厂商
19	天岳先进	过会	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
20	炬光科技	过会	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/24)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
21	希荻微	待上会	民生证券 中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
22	芯龙半导体	问询	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
23	中图科技	问询	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
24	英集芯	待上会	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
25	江波龙	问询	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
26	东微半导体	问询	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
27	莱特光电	问询	中信证券	2010	材料	OLED 有机材料
28	唯捷创芯	问询	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
29	龙芯中科	问询	中信证券	2010	设计	CPU
30	纳芯微	问询	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
31	晶合集成	问询	中金公司	2015	设计	面板驱动芯片
32	麦斯克	问询	国泰君安	1995	材料	硅片
33	甬矽电子	问询	平安证券	2019	封测	封测
34	比亚迪半导体	问询	中金公司	2004	设计	功率半导体
35	赛微微	问询	国泰君安	2009	设计	电源管理芯片
36	中微股份 (深圳)	问询	中信证券	2001	设计	混合信号 SoC
37	龙腾半导体	问询	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
38	盛景微	问询	光大证券	2016	设计	物联网控制芯片
39	臻镭科技	问询	中信证券	2015	设计	射频芯片、电源管理芯片
40	思特威	待上会	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
41	天德钰	问询	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
42	奥比中光	问询	中信建投	2013	设计	深度引擎数字芯片、专用感光模拟芯片
43	好达电子	问询	安信证券	1999	设计	SAW Filter
44	焊映微	问询	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
45	沈阳拓荆	问询	招商证券	2010	设备	薄膜沉积设备
46	峰岷科技	问询	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
47	广立微	问询	中金公司	2003	软件/设备	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
48	富乐德	问询	光大证券	2017	服务	泛半导体(半导体、显示面板等)领域设备精密洗净、维修等服务
49	中科蓝讯	问询	中金公司	2016	设计	无线音频 SoC 芯片
50	国微思尔芯	问询	中金公司	2003	软件	EDA
51	路维光电	问询	国信证券	2012	材料	掩模板
52	联动科技	问询	海通证券	1998	设备	半导体自动化测试系统
53	思科瑞	暂缓审议	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
54	安芯电子	已受理	国元证券	2012	设计	FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能 STD 芯片
55	恒烁股份	已受理	国元证券	2015	设计	存储芯片和 MCU 芯片研发
56	金海通	已申报	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机
57	铖昌科技	已申报	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
58	杰理科技	已申报	中信建投	2014	设计	射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片 (SOC)
59	国博电子	已申报	招商证券	2010	设计	有源相控阵 T/R 组件、砷化镓基站射频
60	德邦科技	已申报	东方证券	2003	材料	半导体封装、粘合、散热等功能性材料
61	德明利	已申报	东莞证券	2008	设计	闪存主控芯片
62	华微科技	已申报	华泰联合	2003	设计	MCU、FPGA、电源管理芯片
63	艾森半导体	完成上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
64	江苏影速	完成上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
65	海光信息	完成上市辅导	中信证券	2014	设计	CPU
66	帝奥微电子	完成上市辅导	中信建投	2010	设计	混合信号产品线、电源管理、ACDC 高压大功率产品、模拟集成电路设计
67	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
68	中科飞测	上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备
69	苏州赛芯微	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/24)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
70	耐科装备	上市辅导	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
71	歌尔微电子	上市辅导	中信建投	2017	设计	MEMS 芯片、ASIC 芯片、智能语音处理芯片
72	和美精艺	上市辅导	开源证券	2007	材料	封装基板
73	金誉半导体	上市辅导	浙商证券	2011	设计	电源管理芯片、低中高压 MOS 管、单片机和功率器件
74	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试
75	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
76	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
77	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导系列无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
78	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管
79	富创精密	上市辅导	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理
80	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
81	【杭州】国芯科技	上市辅导	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
82	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
83	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
84	南麟电子	上市辅导	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
85	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
86	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	一站式定制芯片及 IP 供应商
87	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
88	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
89	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
90	兰宝传感	上市辅导	海通证券	1998	设计	传感器
91	敏芯半导体	上市辅导	中金公司	2017	设计	光通信用激光器和探测器芯片
92	泰凌微	上市辅导	安信证券	2010	设计	高性能低功耗无线物联网 SOC
93	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
94	飞驒科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
95	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料
96	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
97	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片
98	汇成真空	上市辅导	东莞证券	2006	设备	真空应用设备
99	芯愿景	上市辅导	民生证券	2002	设计	IC 技术分析、IC 设计服务
100	越亚半导体	上市辅导	方正证券	2006	材料	封装基板
101	中巨芯	上市辅导	海通证券	2017	材料	电子湿化学品、电子特种气体、半导体前驱体
102	锐成芯微	上市辅导	华泰联合	2011	软件	IP 授权
103	新恒汇电子	上市辅导	平安证券	2017	封测/材料	晶圆测试减划、封装材料高精度蚀刻金属引线框架、物联网 eSIM 封装
104	映日科技	上市辅导	安信证券	2015	材料	靶材
105	绍兴中芯	上市辅导	海通证券	2018	代工	专注于功率、传感和传输应用, 特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工服务的制造商
106	有研半导体	上市辅导	中信证券	2001	材料	硅片
107	京仪装备	上市辅导	国泰君安	2016	设备	半导体温控装置系列 (Chiller)
108	盛科通信	上市辅导	中金公司	2019	设计	以太网交换芯片
109	思必驰	上市辅导	中信证券	2007	设计	AI 芯片
110	欣盛半导体	上市辅导	中信建投	2016	IDM	COF 封装显示驱动芯片
111	振华风光	上市辅导	中信证券	2005	IDM	高可靠半导体模拟集成电路
112	立功科技	上市辅导	国信证券	1999	分销	代理分销
113	蓝箭电子	上市辅导	金元证券	1998	分立器件	三极管、二极管和场效应管, 同时对外承接半导体封装测试
114	兴福电子	上市辅导		2008	材料	电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品
115	燕东微	上市辅导	中信建投	1987	IDM	功率半导体、声光电传感器、声光电 ASIC、精密器件
116	微导纳米	上市辅导	浙江证券	2015	设备	ALD 和 RIE
117	新相微	上市辅导	中金公司	2005	设计	LCD 驱动芯片、CMOS SENSOR
118	慧智微	上市辅导	华泰联合	2011	设计	高性能微波射频前端芯片

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/10/24)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
119	灿瑞科技	上市辅导	中信证券	2005	设计	光电驱动芯片、磁传感器、光学传感器
120	海光芯创	上市辅导	华泰联合	2011	设计	光电子芯片和光电子器件
121	忆恒创源	上市辅导	中金公司	2011	设计	企业级 NVMe SSD 产品
122	新汇成	上市辅导	海通证券	2011	封测	驱动 IC 的金凸块、测试、切割和封装 (COG/COF) 服务
123	芯思杰	上市辅导	中信证券	2015	制造	光芯片设计、制造、封测
124	汇春科技	上市辅导	长江证券	2007	设计	光电成像、触控、MCU 等芯片
125	炬泉光电	上市辅导	国金证券	2005	设计	计量芯片、MCU 和电力载波芯片
126	星宸科技	上市辅导		2017	设计	视频监控芯片
127	中感微	上市辅导	国金证券	2009	设计	音频传感网主芯片、视频传感网芯片、电池电源管理芯片
128	腾盛精密	上市辅导	国金证券	2006	设备	封测设备
129	佰维储存	上市辅导	中信证券	2010	封测	智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组和以 SiP 为核心的先进封测服务
130	润玛电子	上市辅导	海通证券	2002	材料	微电子制造用超净高纯电子化学品
131	招金励福	上市辅导	民生证券	2002	材料	封装材料

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

半导体设备国产化情况

据国内主流 12 英寸产线的半导体工艺设备招投标数据统计，在 12 类主要半导体设备中，国产化程度最高的去胶设备国产化率为 82.4%，CMP、清洗、热处理、刻蚀、PVD 等设备的国产化率接近或超过 20%。镀铜、CVD、量测、离子注入、光刻、涂胶显影等设备的国产化程度仍处于较低水平。

图表 2. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化情况及主要国内厂家

序号	设备名称	国产化率(%)	主要国内厂家
1	去胶设备	82.4	屹唐半导体
2	CMP 设备	26.5	华海清科
3	清洗设备	25.0	盛美半导体、北方华创、芯源微
4	热处理设备	24.7	北方华创、屹唐半导体、盛美半导体
5	刻蚀设备	22.4	中微公司、北方华创、屹唐半导体
6	PVD 设备	19.8	北方华创
7	镀铜设备	4.0	盛美半导体
8	CVD 设备	3.1	沈阳拓荆、盛美半导体
9	量测设备	2.8	上海精测、中科飞测、上海睿励、东方晶源
10	离子注入设备	1.5	中科信、万业企业
11	光刻设备	1.4	上海微电子
12	涂胶显影设备	1.1	芯源微

资料来源：中国国际招标网，中银证券

2021 年前三季度业绩公告

2021 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 24 日，共有 8 家半导体公司发布 2021 年前三季度业绩公告，其中 7 家归母净利润同比增幅超 100%。国科微前三季度归母净利润同比大幅增长 11918.19%，实现净利润约 1.81 亿元，主要因为多个产品线收入增加较多所致。晶丰明源前三季度归母净利润较上年同期大幅增长 1818.71%，实现净利润约 5.73 亿。

图表 3. 上周半导体企业前三季度业绩公告汇总

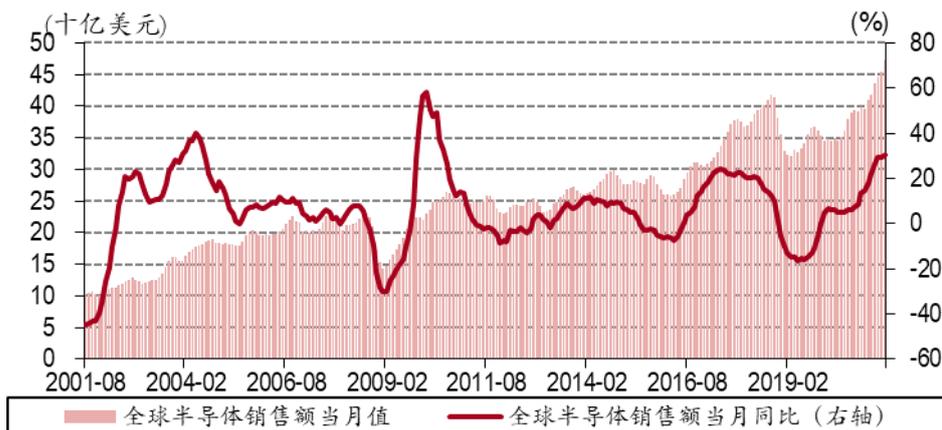
序号	类别	证券代码	证券简称	业绩公告	业绩变动归因	披露时间
1	分立器件	300623.SZ	捷捷微电	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 3.89 亿,比上年同期增长 100.80%	主要原因系公司销售收入较上年同期有较大幅度的增长致净利润同比增长所致。公司聚焦主业发展方向,继续深耕功率半导体,紧紧抓住“推动我国基础电子元器件产业实现高质量发展”、基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)及积极推进功率半导体进口替代的发展契机,公司报告期主营业务收入较上年同期有较大幅度的增长,环比保持良好的增长,其中:MOS、小信号系列产品同比增长超 170%,可控硅业务同比增长 73.7%。	2021-10-20
2	分立器件	605111.SH	新洁能	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 3.11 亿,比上年同期增长 207.83%	主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重点客户,持续进行结构优化,促进销售规模扩大和毛利率的提升所致。	2021-10-22
3	模拟芯片设计	300782.SZ	卓胜微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 15.27 亿,比上年同期增长 112.84%	主要系销售增长,本期经营净利润增加所致。其受益于 5G 通信技术的发展和公司前瞻性产品布局,公司射频模组产品在终端客户持续渗透。报告期内,非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响金额为 1,976.07 万元。	2021-10-22
4	数字芯片设计	300327.SZ	中颖电子	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 2.68 亿,比上年同期增长 78.17%	主要系盈利增加所致。前三季度,公司实现的销售额及毛利率同比均增长,带动盈利大幅提升。AMOLED 显示驱动芯片销售同比增长数倍,锂电池管理芯片销售同比增长逾倍,其他产品线的销售同比稳定增长。毛利率同比略有提高,主要受售价提升及产品组合变动影响。	2021-10-22
5	数字芯片设计	688368.SH	晶丰明源	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 5.73 亿,比上年同期增长 1818.71%	主要系下游市场需求旺盛,公司产品结构优化及毛利提升所致。	2021-10-22
6	数字芯片设计	300672.SZ	国科微	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 1.81 亿,比上年同期增长 11918.19%	主要系本报告期多个产品线收入增加较多所致。	2021-10-22
7	数字芯片设计	600171.SH	上海贝岭	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 5.07 亿,比上年同期增长 276.49%	主要系本期业务增长所致。	2021-10-23
8	半导体设备	688200.SH	华峰测控	公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润约为 3.11 亿,比上年同期增长 127.57%	主要系销售收入大幅度增加所致。	2021-10-23

资料来源: 万得, 中银证券

行业数据回顾

8月全球半导体销售额达472亿美元，同比增长30.2%，环比增长3.8%。据美国半导体产业协会SIA数据，8月全球半导体销售额继续保持增长，较7月销售额454亿美元增长3.8%。其中，8月份中国大陆半导体销售额为164.6亿美元，同比增长30.8%，环比增长3.4%。

图表4. 全球半导体销售额当月值



资料来源：万得，美国半导体产业协会，中银证券

8月北美半导体设备出货金额36.5亿美元，近8个月后首次环比回落。据SEMI统计，8月北美半导体设备出货金额为36.5亿美元，较7月的38.6亿美元下滑5.4%，较2020年同期32.5亿美元上升37.6%。2021年1-8月份出货额的环比增幅分别为13.3%、3.5%、4.2%、4.7%、4.7%、2.3%、4.5%、-5.4%。

图表5. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比



资料来源：万得，SEMI，中银证券

8月日本半导体设备出货金额2457亿日元，较上月略有上涨。据日本半导体制造装置协会统计，8月日本半导体设备出货金额小幅回升，较7月的2407亿日元上涨2.1%，相比于2020年同期1884亿日元上升30.4%。2021年1-8月份出货额的环比增幅分别为1.9%、3.7%、28.4%、17.2%、8.3%、-18.3%、-3.5%、2.1%。

图表 6. 日本半导体设备制造商出货额与同比



资料来源: 万得, 日本半导体制造装置协会, 中银证券

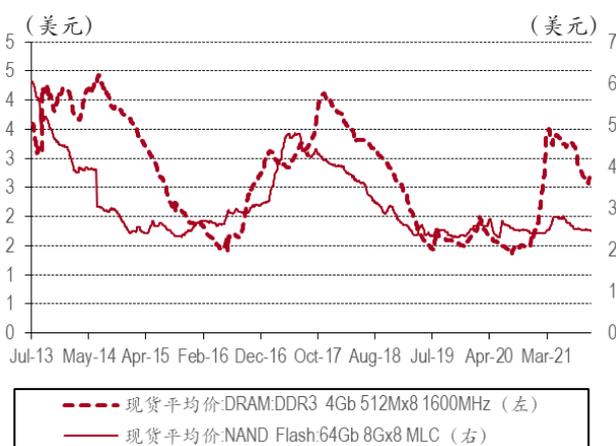
半导体指数涨跌不一, 存储价格略有下降。近一周申万行业半导体指数报 6,114.5 点, 环比下跌 0.13%, 延续前期震荡趋势, 表明市场观点持续分化。费城半导体指数小幅上升, 收报 3370.3 点, 环比上涨 1.69%。近一周存储现货平均价小幅下跌, NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC 价格环比下跌 0.6%, DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz 价格较上周下跌 0.3%, 存储价格结束了上周的反弹, 价格有所回落。

图表 7. 美国与国内半导体指数对比



资料来源: 万得, 中银证券

图表 8. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比



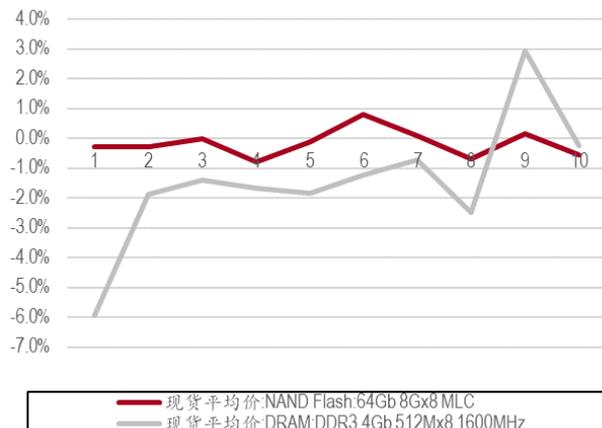
资料来源: 万得, 中银证券

图表 9. 美国与国内半导体指数对比(周度环比)



资料来源: 万得, 中银证券

图表 10. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比(周度环比)



资料来源: 万得, 中银证券

上周申万半导体材料指数收报 10,022.8 点，较上周上涨 3.7%。10 月 12 日半导体材料指数收报 9110.1 点，降至三个月低点，之后半导体材料指数触底反弹，截至 10 月 22 日半导体材料指数较 12 日低点已上涨 10.0%。

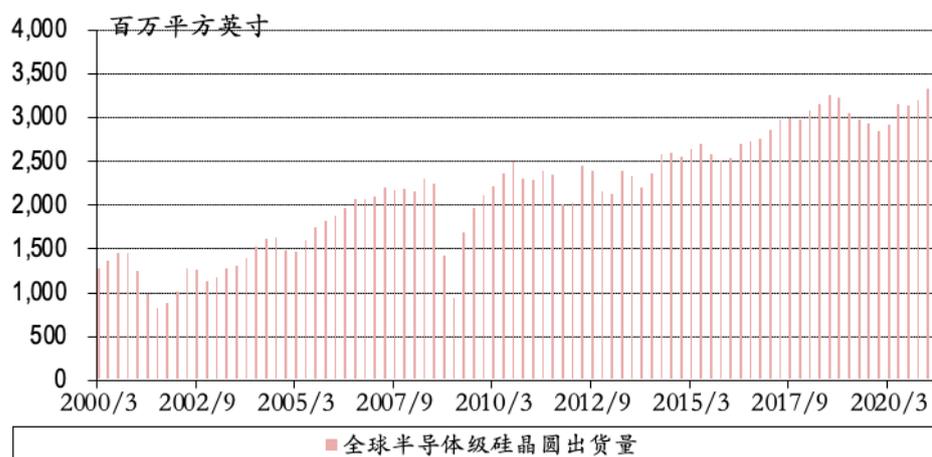
图表 11. 申万半导体材料指数



资料来源：万得，SEMI，中银证券

硅晶圆：SEMI 发布年度半导体产业硅晶圆出货预测报告，环球晶圆与世创的合并可能延迟完成。 SEMI 20 日发布年度半导体产业硅晶圆出货预测报告，预估今年硅晶圆出货量增幅将达 13.9%，接近 140 亿平方英寸。同时预估明年出货量将增长 6.4%，达 148.96 亿平方英寸，2023、2024 出货量将分别增长 4.6%、2.9%，续创历史新高。据 22 日 Siltronic 最新公告指出，因当局机关审查许可需要时间，与环球晶圆的合并可能延迟完成。

图表 12. 全球半导体级硅片出货量

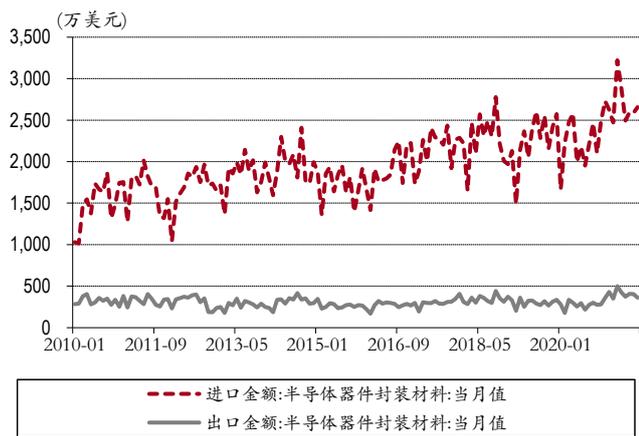


资料来源：SEMI，中银证券

光刻胶：上海新阳公告将支付 4500 万元受让芯刻微剩余的 30% 股权。 芯刻微目前系公司的控股子公司，仅进行 ArF 浸没式光刻胶的研发工作，2020 年公司为了芯刻微引入战略投资者超成科技，在超成科技作为芯刻微大股东的期间，芯刻微完成了项目的前期研发、团队建设、实验室的工程建设工作，并避免公司或有的风险损失，保证了湿法光刻胶项目的正常开展。考虑到湿法光刻胶的研发工作已经达到了中试试验的基本条件，为避免同业竞争并加快项目的测试验证工作，上海新阳拟继续受让由超成科技持有的芯刻微剩余的 30% 股权，将芯刻微纳入 100% 控股子公司。ArF 浸没式光刻胶在芯刻微实现了从无到有的过程并研发工作进展顺利，取得可观的发展成果。

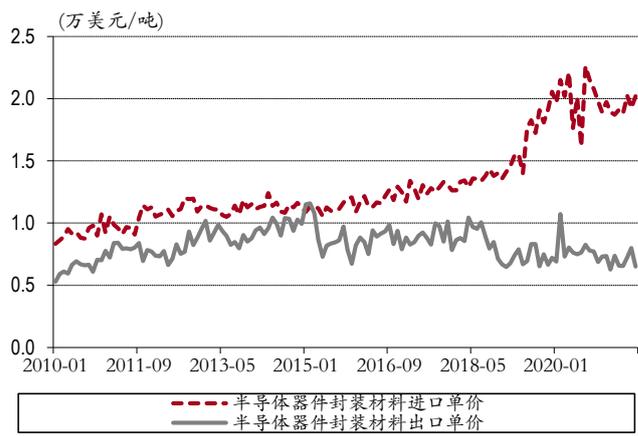
封装材料：半导体封装材料厂商德邦科技闯关科创板。10月12日，根据上海证券交易所官网信息，烟台德邦科技股份有限公司科创板上市申请获受理。招股书介绍称，该公司是国家集成电路产业基金重点布局的半导体材料生产企业，在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下，公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破，并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研究生产体系并拥有完全自主知识产权。其中，在集成电路领域，德邦科技的主要客户有长电科技、通富微电、华天科技等知名封测企业。德邦科技的第一大股东为国家集成电路产业投资基金股份有限公司（国家集成电路基金），持股比例24.87%。

图表 13. 半导体器件封装材料进出口金额



资料来源：万得，海关总署，中银证券

图表 14. 半导体器件封装材料进出口单价



资料来源：万得，海关总署，中银证券

图表 15. 上周半导体相关个股周度涨跌幅

代码	简称	周度跌幅 (%)	代码	简称	周度涨幅 (%)
688368.SH	晶丰明源	(19.60)	300672.SZ	国科微	18.42
688766.SH	普冉股份	(10.52)	002610.SZ	爱康科技	11.40
300323.SZ	华灿光电	(9.54)	002459.SZ	晶澳科技	11.34
300029.SZ	*ST 天龙	(9.44)	605111.SH	新洁能	10.00
300139.SZ	晓程科技	(8.20)	600732.SH	爱旭股份	9.19

资料来源：万得，中银证券

上周信息汇总

IC 设计

【行业】IC 设计公司提高报价难度加大

集微网消息，据业内消息人士称，由于客户越来越不愿意接受进一步的涨价，中国台湾地区的 IC 设计公司尤其是从事消费类 IC 设计的公司正面临着转嫁成本的压力。据了解，目前汽车芯片和电源管理 IC 继续面临供应紧张的局面，这使得英飞凌、瑞萨、德州仪器和意法半导体等 IDM 以及其他相关供应商提高了以上两种芯片的价格，以弥补生产和原材料成本的增加。但部分消费类 IC 价格开始面临下行压力，尽管台积电明年将代工报价上调 10-20%，其他同行也将跟进，但芯片供应商将发现在 2022 年第一季度提高报价的难度越来越大。

(资料来源：集微网)

【圣邦股份】拟 3 亿元设立子公司投建 IC 设计及测试项目

10 月 20 日，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）发布公告称，公司拟与江阴高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》。根据公告，圣邦股份拟在江阴高新技术产业开发区内投资设立全资子公司江阴圣邦微电子有限公司（以下简称“江阴圣邦微电子”）（暂定名，最终以工商行政管理部门核定名称为准）作为项目实施主体，计划用地面积约 30 亩，建设集成电路设计及测试项目，该项目总投资金额约人民币 3 亿元。江阴圣邦微电子注册资本为 5000 万元，出资方式为货币出资，为上市公司自有资金。圣邦股份表示，公司本次拟对外投资符合国家政策以及公司的长期发展战略，有利于增强公司的综合实力，扩大团队规模，完善公司产业布局。

(资料来源：圣邦股份公告)

半导体设备

【行业】SEMI：9 月北美半导体设备出货 37.2 亿美元 同比上升 35.5%

SEMI（国际半导体产业协会）10 月 22 日公布最新出货报告显示，今年 9 月北美半导体设备制造商出货金额为 37.2 亿美元，较上月小幅增加 1.7%，同比上升 35.5%，也是今年以来的单月次高水准，仅次于 7 月的 38.57 亿美元。

(资料来源：财联社)

【中微公司】公司计划扩展在泛半导体领域设备的应用，布局显示、MEMS、功率器件、太阳能领域的关键设备

中微公司（688012.SH）10 月 22 日在投资者互动平台表示，公司持续从三个维度扩展业务布局：深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用并探索其他新兴领域的机会。在集成电路设备领域，公司将持续强化在刻蚀设备领域的竞争优势，并延伸到薄膜、检测等其他关键设备领域；公司计划扩展在泛半导体领域设备的应用，布局显示、MEMS、功率器件、太阳能领域的关键设备；公司拟探索其他新兴领域的机会，利用好设备及工艺技术，考虑从设备制造向器件大规模生产的机会，以及探索更多集成电路及泛半导体设备生产线相关领域的市场机会。

(资料来源：上证 e 互动)

半导体材料

【行业】荣耀半导体嘉善厂投产，加快半导体包装材料国产化进程

10月19日，荣耀半导体材料（嘉善）有限公司宣布，位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鼎阳路1号（北创科技产业园）的新工厂正式试营运。该工厂由荣耀电子材料（重庆）有限公司全资投资建立，旨在推动荣耀自身发展的同时，助力加速半导体包装材料国产化的步伐。荣耀电子材料（重庆）有限公司是由中科院上海微系统所下属新微资本和嘉善县经开区联合投资的一家为半导体企业提供包装方案的民营企业，公司拥有一支精通半导体包装技术和熟知半导体客户要求的专业团队。工厂建有国内一流的半导体包装材料设计开发，模具制造，注塑成型，清洁清洗，检验检测全流程产线。公司全面推行ISO9001质量管理体系，产品和服务质量媲美全球业界先进水平。目前荣耀半导体材料客户群体包括硅片生产商，FAB，封测，化合物半导体，蓝宝石LED等行业，嘉善工厂的建立标志着荣耀半导体材料正在逐步担起国内半导体包装材料行业领头羊角色

（资料来源：科创板日报、集微网）

【众合科技】半导体材料生产未受到限电政策的明显影响

众合科技10月22日在投资者互动平台表示，公司的股价受到宏观经济、大盘及板块走势等多种因素的共同影响。公司三季报业绩净利润1.013亿元至1.225亿元，增长幅度为72.33倍至87.74倍。国家限电政策对公司的影响：公司智慧交通业务不涉及生产制造，半导体材料生产目前尚未受到国家限电政策的明显影响，经营一切正常，并继续维持今年上半年的良好发展态势。

（资料来源：上证e互动）

晶圆代工

【行业】日本半导体设备商从越南向中国分散生产

日本经济新闻22日报道，开展半导体晶圆传送设备业务的日本Rorze将对集中于越南的生产体制进行调整。Rorze的业绩维持强劲势头，但课题是产能集中于越南。在越南约有2200名员工，超过集团整体的7成。目前半导体相关设备的7-8成在越南生产。2021年内，Rorze将在中国大陆的子公司设置小型无尘车间（Clean Room），对于已在越南完成一定程度组装的设备，根据客户的要求进行最终组装和微调。到2022财年（截至2023年2月）以后，将在中国大陆充分利用具备无尘车间的租赁工厂。将展开设备投资，使得工厂能够进行大型设备组装。为应对中国台湾企业等的需求，将同时通过分散生产基地，加强业务连续性计划（BCP）。以物联网（IoT）和5G手机的普及等为东风，全球半导体需求持续增加。Rorze来自中美半导体厂商的订单正在增加，预计2021财年（截至2022年2月）的合并净利润同比增长70%，增至109亿日元，将创出历史利润新高。

（资料来源：经济观察报）

【行业】台湾晶圆代工厂将再次提价

全球晶圆代工龙头企业台积电又传出涨价的消息。代工厂消息人士21日称，晶圆代工报价预计将继续上涨，其中台积电12月后或将调涨20%，联华电子也已通知客户，明年1月起产品价格将再次上调不到10%。台湾另两家代工商世界先进半导体与力积电2022年第一季度能否进一步续涨目前仍与客户讨论中，只是议价强度不及台积电。

（资料来源：环球时报）

【民德电子】拟 6000 万元增资晶圆代工公司 强化功率半导体产业链布局

10月19日，民德电子发布公告称，为进一步完善公司在功率半导体产业“硅片—晶圆代工—设计公司”的全产业链 Smart IDM 生态圈布局，满足公司功率半导体产业日益增长的晶圆代工产能需求，大幅提升功率半导体新产品开发效率，提升公司功率半导体产业核心竞争力，民德电子拟与晶圆代工企业浙江广芯微电子，及浙江广芯微电子的股东谢刚签订投资协议，约定由公司向目标公司增资 6,000 万元，增资款来源为公司自有资金。该项目主要建设年产 120 万片 6 英寸高端特色硅基晶圆代工生产线，达产后可实现产值 10.2 亿元。

(资料来源：民德电子公告、全球半导体观察)

封测

【深科达】拟发行可转债募资不超 3.6 亿元 布局平板显示/封测设备等项目

10月22日，深科达发布公告称，公司拟向不特定对象发行可转债募资不超过 3.6 亿元，用于惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目、平板显示器件自动化专业设备生产建设项目、补充流动资金等。

(资料来源：深科达公告)

【汉威科技】募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”、“新建年产 150 万只气体传感器生产线”增加炜盛科技为实施主体

10月21日，汉威科技(300007.SZ)公布，公司于 2021 年 10 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”、“新建年产 150 万只气体传感器生产线”增加郑州炜盛电子科技有限公司(“炜盛科技”)为实施主体，即该项目的实施主体为公司及其全资子公司炜盛科技。此次部分募集资金投资项目增加实施主体不属于变更募集资金使用用途，无需经过公司股东大会批准。

(资料来源：汉威科技公告)

风险提示

疫情影响超预期：新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓：新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

半导体材料国内市场增速放缓：半导体材料从世界范围来看是个增速较为缓慢的市场，中国市场在过去5年中CAGR达到了10%，远高于世界平均水平。若半导体材料进入下行周期，目前国内市场的增速将难以持续。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备：由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20% 以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在 -10%-10% 之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10% 以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371